

テキサス・インスツルメンツ: 次の時代を築く米国ユタ州 リーハイの半導体製造工場

製造能力の拡大

- LFAB で長期的に 30 億ドル～ 40 億ドルを投資の見込み
- LFABでの生産は、約1年後の2022年末に開始
- 65nm および45nm の技術をサポート

高度な 製造能力

- LFABに275,000平方フィート (25,000 平方メートル) 以上のクリーンルームスペースを確保
- 7 マイル (11km)におよぶ頭上運搬設備でLFAB内のウェハーをシームレスに運搬
- 毎日製造される数千万個のアナログおよび組み込みチップは、出荷後、あらゆるエレクトロニクス機器で採用されている

持続可能な未来

- サステナブル(持続的)で責任のある製造に対する長年の取り組み
- 先進的な機器と施設のアップグレードを通して、廃棄物、水、エネルギーの消費量を削減

強いコミュニティ

- 複数の地域団体を支援する積極的なコミュニティ参加チーム
- 2022年に2,100時間以上のボランティア活動を実施
- 2022 年はユタ州のコミュニティに合計 600,000 ドル以上を投資

米国ユタ州リーハイにおける取組の
詳細はこちら [TI.com/Lehi](https://news.tij.co.jp/ja-jp/news-releases/content-id-127868)
(<https://news.tij.co.jp/ja-jp/news-releases/content-id-127868>) をご覧ください

